

### 三五、質抵押資產

合併公司提供下列資產作為長期銀行借款之擔保品：

	112年9月30日	111年12月31日	111年9月30日
不動產、廠房及設備	\$ 3,372,744	\$ 3,253,733	\$ 3,201,704
應收帳款	1,695,716	3,197,362	3,987,699
存 貨	229,974	190,021	267,816
	<u>\$ 5,298,434</u>	<u>\$ 6,641,116</u>	<u>\$ 7,457,219</u>

上述部分質抵押資產係屬提供予未動用額度擔保之長期銀行借款。

### 三六、重大或有負債及未認列之合約承諾

除已於其他附註所述者外，合併公司於資產負債表日之重大承諾事項及或有事項如下：

#### (一) 重大承諾

1. 合併公司未認列之合約承諾如下：

	112年9月30日	111年12月31日	111年9月30日
購置不動產、廠房及設備	<u>\$ 4,360,194</u>	<u>\$ 8,264,182</u>	<u>\$10,249,050</u>
出售不動產、廠房及設備	<u>\$ 1,960,200</u>	<u>\$ 2,114,475</u>	<u>\$ 1,996,500</u>

2. 合併公司為持續聚焦高階利基型領域的營運策略，進一步拓展高度設計的產品組合，成為高階電子零組件解決方案的領導供應商，於111年10月經董事會決議通過擬以現金對價歐元6.86億元，取得施耐德電機高階工業感測器事業部。

#### (二) 或有事項

##### 或有負債

1. 本公司為子公司及子公司間背書保證情形請參閱附表二。